

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 *

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 981)

须予披露交易

根据批量采购协议及购买单作出购买

本公司公布，本公司根据批量采购协议已于 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日的 12 个月期间就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单。

由于有关阿斯麦购买单于香港上市规则第 14 章规定的一个或多个适用的百分比率高于 5% 但低于 25%，阿斯麦购买单构成本公司的须予披露交易，须遵守香港上市规则第 14 章的公告规定。

绪言

于 2021 年 2 月 1 日，本公司与阿斯麦上海签订了经修订和重述的阿斯麦批量采购协议，据此，阿斯麦批量采购协议的期限从原来的 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日延长至从 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本公司根据批量采购协议已于 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日的 12 个月期间就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单。

批量采购协议作为阿斯麦购买单所载条款及条件的参考，且批量采购协议下的购买是通过本公司签订购买单来实现的。

经修订和重述的阿斯麦批量采购协议及阿斯麦购买单

经修订和重述的阿斯麦批量采购协议

日期及订约方

日期：2021 年 2 月 1 日

订约方：

(1) 本公司；及

(2) 阿斯麦上海

本公司确认，经作出所有合理查询后所深知、所悉及所信，阿斯麦上海及其最终实益拥有人为独立于本公司及其关连人士的第三方。

协议年期

本协议的有效期直至 2021 年 12 月 31 日止。

经修订和重述的阿斯麦批量采购协议的主要条款

付款

阿斯麦产品及其他设备的定价是在每次根据经修订和重述的阿斯麦批量采购协议发出购买单时另行厘定。

每项阿斯麦产品的付款条款为：

(1) 于发出相关购买单后约百分之三十(30%)的首期付款；及

(2) 余下款额将于交付相关阿斯麦产品时支付。

付运

根据阿斯麦购买单作出的购买的付运条款应为 FCA（货交承运人）承包商的处所或指定目的地交货(DAP)。

阿斯麦购买单

阿斯麦购买单乃于 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日之间就阿斯麦集团向本公司供应用于生产晶圆的机器而作出。

根据阿斯麦购买单购买的阿斯麦产品定价乃按公平基准厘定。阿斯麦购买单的总代价为 1,201,598,880 美元。

有关订约方的资料

本公司及其附属公司共同构成世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进全面、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。本集团总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座 300mm 晶圆厂、一座 200mm 晶圆厂和一座实际控制的 300mm 先进制程晶圆合资厂；在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 晶圆厂；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂；在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。本集团还在美国、欧洲、日本和中国台湾地区设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

ASML Holding N.V. 是在荷兰注册成立的公司，并在阿姆斯特丹泛欧交易所和纳斯达克上市。ASML Holding N.V. 为半导体业的全球领先供货商之一，向全球芯片制造商提供硬件、软件及服务。阿斯麦香港和阿斯麦上海是 ASML Holding N.V. 的附属公司。

订立批量采购协议的理由及益处

本公司为中国最先进及最大的集成电路制造商。为应对客户的需要，本公司继续扩大其产能、把握市场商机及增长。

批量采购协议及阿斯麦购买单乃于本公司正常业务过程中就购置用于生产晶圆（为本公司主要业务）的相关机器作出。由于阿斯麦批量采购协议的期限已到期，本公司签订经修订和重述的阿斯麦批量采购协议。

董事认为，批量采购协议及阿斯麦购买单各自的条款公平合理，符合本公司及其股东整体的利益。

香港上市规则的涵义

阿斯麦购买单为于 12 个月期间作出的一系列阿斯麦产品采购，而根据香港上市规则第 14.22 及 14.23 条，被合并计算及视作有关购买的单一交易。

由于有关阿斯麦购买单于香港上市规则第 14 章规定的一个或多个适用的百分比率高于 5% 但低于 25%，阿斯麦购买单构成本公司的须予披露交易，须遵守上市规则第 14 章的公告规定。

释义

于本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「经修订和重述的阿斯麦批量采购协议」

指 本公司与阿斯麦上海订立日期为 2021 年 2 月 1 日的经修订和重述的阿斯麦批量采购协议；

「阿斯麦集团」	指	阿斯麦香港和阿斯麦上海的统称；
「阿斯麦香港」	指	阿斯麦香港有限公司；
「阿斯麦产品」	指	由扫描器组成的资本设备；
「阿斯麦购买单」	指	于 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日根据批量采购协议就阿斯麦产品发出的购买单；
「阿斯麦上海」	指	阿斯麦（上海）机电设备有限公司；
「阿斯麦批量采购协议」	指	本公司与阿斯麦香港订立日期为 2018 年 1 月 1 日的阿斯麦批量采购协议；
「董事会」	指	董事会；
「本公司」	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司*）；
「董事」	指	本公司董事；
「香港上市规则」	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
「中国」	指	中华人民共和国；及
「批量采购协议」	指	阿斯麦批量采购协议和经修订和重述的阿斯麦批量采购协议的统称。

承董事会命

中芯国际集成电路制造有限公司

高永岗博士

执行董事、首席财务官兼公司秘书

中国上海， 2021 年 3 月 3 日

于本公告日期， 本公司董事分别为：

执行董事

周子学（董事长）

蒋尚义（副董事长）

赵海军（联合首席执行官）

梁孟松（联合首席执行官）

高永岗（首席财务官兼公司秘书）

非执行董事

陈山枝

周杰

任凯

路军

童国华

独立非执行董事

William Tudor Brown

刘遵义

范仁达

杨光磊

刘明

* 仅供识别